

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

### 中芯截至二零零九年十二月三十一日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零九年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。
- 二零零九年第四季的總銷售額由二零零九年第三季的 323,400,000 元上升 3.0% 至 333,100,000 元，與二零零八年第四季相比上升 22.2%。二零零九年第四季大中國區的晶圓收入佔總收入的 38.1%。二零零九年第四季的毛利率由二零零九年第三季的 0.8%改善至 10.6%是由於晶圓的出貨量增加及產能使用率增加所致。二零零九年第四季來自於經營活動的現金淨額由二零零九年第三季的 73,000,000 元大幅增加至 89,800,000 元。二零零九年第四季與訴訟和解相關的費用為 299,700,000 元；與長期資產減值相關的費用為 139,100,000 元，總計 438,800,000 元分別認列在經營開支和非經營開支下。二零零九年第四季普通股持有人應佔虧損上升為 482,300,000 元；二零零九年第三季普通股持有人應佔虧損為 69,300,000 元。每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 1.0779 元。
- 以下為本公司於二零一零年二月九日就截至二零零九年十二月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零一零年二月九日作出本公佈。

以下為本公司於二零一零年二月九日就截至二零零九年十二月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零一零年二月九日—國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零九年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

## 二零零九年第四季概要

- 二零零九年第四季的總銷售額由二零零九年第三季的 323,400,000 元上升 3.0%至 333,100,000 元，與二零零八年第四季相比上升 22.2%。
- 二零零九年第四季大中國區的晶圓收入佔總收入的 38.1%。
- 二零零九年第四季的毛利率由二零零九年第三季的 0.8%改善至 10.6%是由於晶圓的出貨量增加及產能使用率增加所致。
- 二零零九年第四季來自於經營活動的現金淨額由二零零九年第三季的 73,000,000 元大幅增加至 89,800,000 元。
- 二零零九年第四季與訴訟和解相關的費用為 299,700,000 元；與長期資產減值相關的費用為 139,100,000 元，總計 438,800,000 元分別認列在經營開支和非經營開支下。
- 二零零九年第四季普通股持有人應佔虧損上升為 482,300,000 元；二零零九年第三季普通股持有人應佔虧損為 69,300,000 元。
- 每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 1.0779 元。

## 二零一零年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零一零年第一季收入預期按季持平至增加 2%。
- 經營開支去除匯兌損益預期介於 84,000,000 元至 88,000,000 元之間。
- 資本支出預期介於 95,000,000 元至 100,000,000 元之間。

---

在評論第四季度業績時，中芯國際首席執行官王寧國博士表示：“2010年在半導體行業來看似是一個好的年頭。我們相信這也是重要的一步使我們邁向持續盈利之路。

整體而言，2009年第四季度的收入增長符合我們的預期，而毛利率相對上一季度也上升了十倍，其上升是由於平均售價，晶圓出貨量和產能利用率均有所提高所致。同時，我欣喜地宣佈，我們大中華區銷售總額所佔的百分比繼續增加，達到總收入的 38%，而單是中國的銷售額就達到總收入的 21%，比上一季度增長 7%及比去年同期增長 23.6%。最後，我非常高興地看到在 2009 年第四季度，0.13 微米及以下的先進製程收入亦較上一季度增長了 12.9%。”

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一零年二月十日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-3672 / 1-800-260-8140(密碼：SMIC)或香港 852-3002-1672  
(密碼：SMIC)

二零零九年第四季業績公佈網上直播可於 [www.smics.com](http://www.smics.com) 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

---

## 關於中芯國際

中芯國際積體電路製造有限公司（“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981），是世界領先的積體電路晶片代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的積體電路晶片代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45 納米晶片代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶片廠和三座 200mm 晶片廠。在北京建有兩座 300mm 晶片廠，在天津建有一座 200mm 晶片廠，在深圳有一座 200mm 晶片廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯代成都成芯半導體製造有限公司經營管理一座 200mm 晶片廠，也代武漢新芯積體電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶片廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

---

## 安全港聲明

（根據1995 私人有價證券訴訟改革法案）

本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們相信2010年在半導體行業來看似是一個好的年頭及這是重要的一步使我們邁向持續盈利之路和“2010年第一季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、未決訴訟的頒令或判決、能否取得生產力，和終端市場的財政穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零九年六月二十二日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層

對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，並向中芯不時向證交會（包括以 6-K 表格形式），或香港交易所（「港交所」）呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

---

## 訴訟

### 台積電訴訟概覽：

二零零三年十二月起至二零零四年八月，本公司遭台灣積體電路製造股份有限公司（「台積電」）提出若干法律訴訟，指稱本公司侵犯若干專利及挪用有關經營半導體晶圓業務及製造集成電路方法的商業機密。

二零零五年一月三十日，中芯國際及台積電同意在毋須承認責任且不損害兩家公司利益的情況下，解除所有未決法律訴訟（「二零零五年和解協議」）。

二零零六年八月二十五日，台積電入稟加州阿拉米達郡最高法院，指稱本公司違反二零零五年和解協議、違反有關二零零五年和解協議中的承兌票據及挪用商業機密而對本公司及若干附屬公司（即中芯上海、中芯北京及中芯美國）提出訴訟。公司於二零零六年十一月在北京向台積電就不公平競爭和商業誹謗提出訴訟。

二零零九年十一月九日解決與台積電的所有未決訴訟，而二零零九年和解協議（“二零零九年和解協議”）亦於二零零九年十一月九日取代二零零五年和解協議。於二零零九年十一月九日簽訂的二零零九年和解協議解決雙方所有未決的索償，和解和解除所有雙方之間未決的訴訟案，包括中芯國際在加州案中待定的申索和抗辯及公司在北京案的上訴，從而結束雙方所有在法庭未決的訴訟。二零零九年和解協議的條款也被確定包括以下內容：

- (a) 雙方解除所有已經或可能已經訴諸待決訴訟的指控；
- (b) 終止中芯國際根據前份和解協議項下餘下款項（約 40,000,000 美元）的付款責任；
- (c) 向台積電支付合共 200,000,000 美元（於執行時支付 15,000,000 美元，資金將以中芯國際現有現金結餘撥付，餘額將於四年內分期支付-二零零九年十二月三十一日前須付 15,000,000 美元、二零一零年十二月三十一日前須付 80,000,000 美元、二零一一年十二月三十一日前須付 30,000,000 美元、二零一二年十二月三十一日前須付 30,000,000 美元及二零一三年十二月三十一日前須付 30,000,000 美元）；
- (d) 向台積電授出 1,789,493,218 股中芯國際股份（佔中芯國際於二零零九年十月三十一日已發行股本約 8%），以及可按每股股份 1.30 港元的認購價，認購 695,914,030 股中芯國際股份（可予調整）的認股權證（可自發行起三年內行使），致使股份發行生效後，台積電將取得中芯國際已發行股本合共約 10% 擁有權，惟須取得必要的政府及監管批准；及

(e) 倘違反本次和解，則採取若干補救措施。

### **2009 年和解協定會計處理：**

2009 年和解協定由債務解除、訴訟和解、不起訴協定 3 個部分組成。

根據美國會計準則，以上 3 個部分均不能確認為資產，在和解協定生效日確認為費用。另外，對於前期按照 2005 年和解協定確認的資產全額計提減值。股份及認股權授予協定初始計量按照衍生工具以公允價值計價，後續公允價值變動計入當期損益。2009 年第 4 季，公司在營業費用項下確認了 269.6 萬美元的和解費用，衍生工具公允價值變動 30.1 萬美元，期票利息 0.7 萬美元計入利息費用。

投資者聯絡資料：

En-Ling Feng

電話：+86-21-3861-0000，內線： 16275

ir@smics.com

Edith Kwan

電話：+852-2116-2624

ir@smics.com

Stephanie Cheung

電話：+86-21-3861-0000，內線： 16113

ir@smics.com

## 二零零九年第四季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	季度比較	二零零八年 第四季度	年度比較
銷售收入	333,090	323,356	3.0%	272,479	22.2%
銷售成本	297,810	320,702	-7.1%	347,114	-14.2%
毛利(虧損)	35,280	2,654	1229.3%	(74,635)	-
經營開支	496,823	99,184	400.9%	46,445	969.7%
經營虧損	(461,543)	(96,530)	378.1%	(121,080)	281.2%
其他費用，淨額	(29,072)	(3,943)	637.3%	(4,146)	601.2%
所得稅利益（支出）	8,735	31,704	-72.4%	(745)	-
稅後淨虧損	(481,880)	(68,769)	600.7%	(125,972)	282.5%
應佔聯營公司虧損	(114)	(313)	-63.6%	(92)	23.9%
淨虧損	(481,994)	(69,081)	597.7%	(126,064)	282.3%
非控制權益持有人利息	(274)	(265)	3.4%	(13,394)	-98.0%
普通股持有人應佔虧損	(482,268)	(69,346)	595.5%	(139,458)	245.8%
毛利率	10.6%	0.8%		-27.4%	
經營利潤率	-138.6%	-29.9%		-44.4%	
每股普通股股份淨虧損—基本 <sup>(1)</sup>	(0.02)	(0.00)		(0.01)	
每股美國預托股股份淨虧損—基本	(1.08)	(0.16)		(0.37)	
每股普通股股份淨虧損—攤薄 <sup>(1)</sup>	(0.02)	(0.00)		(0.01)	
每股美國預托股股份淨虧損—攤薄	(1.08)	(0.16)		(0.37)	
付運晶圓（8吋等值） <sup>(2)</sup>	436,816	429,843	1.6%	323,175	35.2%
產能使用率	91.5%	87.3%		67.7%	

附注：

(1) 基於二零零九年第四季加權平均普通股 22,370,000,000 股（基本）及 22,370,000,000 股（攤薄），二零零九年第三季 22,368,000,000 股（基本）及 22,368,000,000 股（攤薄），二零零八年第四季 18,948,000,000 股（基本）及 18,948,000,000 股（攤薄）

(2) 包括銅接連件

- 二零零九第四季總銷售額由二零零九第三季的 323,400,000 元上升至 333,100,000 元，錄得季度升幅 3.0%，是由於晶圓出貨量上升 1.6%所致。
- 二零零九第四季的銷售成本與二零零九第三季的 320,700,000 元相比，下降 7.1%至 297,800,000 元是由於折舊費用較低所致。
- 二零零九第四季的毛利為 35,300,000 元，二零零九第三季的毛利為 2,700,000 元，二零零八年第四季的毛利為負 74,600,000 元。
- 二零零九第四季的毛利率由二零零九第三季的 0.8%改善至 10.6%主要是由於晶圓出貨量增加及產能使用率增加所致。
- 二零零九第四季的總經營開支與二零零九第三季的 99,200,000 元相比，錄得季度升幅 400.9%至 496,800,000 元主要由於與訴訟和解相關的費用以及公司部分長期資產的減值損失所致。
- 二零零九第四季的研發費用與二零零九第三季的 50,000,000 元相比，錄得季度降幅 12.4%至 43,800,000 元，主要是由於收到研發相關活動補貼所致。
- 二零零九第四季的一般行政費用與二零零九第三季的 31,900,000 元相比下降至 25,300,000 元，是由於匯兌收益及律師費用減少所致。
- 二零零九第四季的銷售費用由二零零九第三季的 7,700,000 元上升至 7,800,000 元，錄得季度升幅 0.9%。
- 二零零九第四季經營活動下認列的與訴訟和解相關的費用為 269,600,000 元，與長期資產減值相關的費用為 139,100,000 元。包括在非經營性開支項下認列的部分，與訴訟和解相關的費用總計為 299,700,000 元。

## 收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	二零零八年 第四季度
電腦	6.2%	5.3%	4.5%
通訊	49.0%	46.7%	45.9%
消費	38.3%	41.9%	37.5%
其他	6.5%	6.1%	12.1%
以服務分類	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	二零零八年 第四季度
邏輯 <sup>(1)</sup>	90.2%	90.1%	85.6%
記憶	3.4%	4.0%	2.6%
光罩製造，探測及其它	6.4%	5.9%	11.8%
以客戶類別分類	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	二零零八年 第四季度
非廠房半導體公司	64.4%	67.3%	65.0%
集成裝置製造商	17.4%	16.1%	15.2%
系統公司及其它	18.2%	16.6%	19.8%
以地區分類	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	二零零八年 第四季度
北美洲	56.4%	59.2%	59.9%
大中國 <sup>(2)</sup>	38.1%	36.6%	33.6%
亞洲 <sup>(3)</sup>	2.6%	2.9%	4.1%
歐洲	2.9%	1.3%	2.4%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	二零零八年 第四季度
65 納米	2.5%	0.5%	0.0%
90 納米	16.2%	15.8%	11.1%
0.13 微米	39.5%	36.5%	34.4%
0.15 微米	2.7%	2.6%	2.2%
0.18 微米	22.9%	27.8%	32.5%
0.25 微米	0.3%	0.6%	0.6%
0.35 微米	15.9%	16.2%	19.2%

附注：

- (1) 包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 包括香港和臺灣
- (3) 不包括大中國區

- 二零零九年第四季大中國區的晶圓收入佔總收入的 38.1%。
- 0.13 微米及以下先進技術晶圓收入於二零零九年第四季佔總晶圓收入的 58.2%，二零零九年第三季為 52.8%。

## 產能\*

廠／（晶圓尺寸）	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度
上海廠（8吋）	85,000	88,000
北京廠（12吋）	42,750	42,750
天津廠（8吋）	34,300	34,300
每月晶圓裝配總產能	162,050	165,050

附注：

(1) \*期終每月晶圓計 8 吋等值

## 付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	二零零八年 第四季度
付運晶圓（包括銅接連件）	436,816	429,843	323,175
使用率 <sup>(1)</sup>	91.5%	87.3%	67.7%

附注：

(1) 產能使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零零九年第四季晶圓付運數量較二零零九年第三季的 429,843 片 8 吋等值晶圓增加 1.6% 至 436,816 片 8 吋等值晶圓，較二零零八年第四季度的 323,175 片 8 吋等值晶圓錄得年度升幅 35.2%。

## 2. 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	季度比較	二零零八年 第四季度	年度比較
銷售成本	297,810	320,702	-7.1%	347,114	-14.2%
折舊	142,023	155,949	-8.9%	183,916	-22.8%
其他製造成本	152,815	157,843	-3.2%	156,446	-2.3%
遞延成本攤銷	1,962	5,886	-66.7%	5,886	-66.7%
股權報酬	1,010	1,024	-1.4%	866	16.6%
毛利（虧損）	35,280	2,654	1229.3%	(74,636)	-
毛利率	10.6%	0.8%		-27.4%	

- 二零零九年第四季的銷售成本與二零零九年第三季的 320,700,000 元相比，下降 7.1% 至 297,800,000 元是由於折舊費用較低所致。
- 二零零九年第四季的毛利為 35,300,000 元，二零零九年第三季的毛利為 2,700,000 元，二零零八年第四季的毛利為負 74,600,000 元。
- 二零零九年第四季的毛利率由二零零九年第三季的 0.8% 改善至 10.6% 主要是由於晶圓出貨量增加及產能使用率增加所致。

### 經營開支分析

以千美元計	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	季度比較	二零零八年 第四季度	年度比較
總經營開支	496,823	99,184	400.9%	46,445	969.7%
研究及開發	43,806	50,003	-12.4%	12,524	249.8%
一般及行政	25,297	31,922	-20.8%	16,146	56.7%
銷售及市場推廣	7,760	7,693	0.9%	5,843	32.8%
無形資產攤銷	7,641	9,535	-19.9%	11,564	-33.9%
資產處置損失（收入）	3,585	29	12262.1%	(599)	-
長期資產減值損失	139,097	-	-	967	14284.4%
訴訟和解	269,637	-	-	-	-

- 二零零九年第四季的總經營開支與二零零九年第三季的 99,200,000 元相比，錄得季度升幅 400.9% 至 496,800,000 元主要由於與訴訟和解相關的費用以及公司部分長期資產的減值損失所致。
- 二零零九年第四季的研發費用與二零零九年第三季的 50,000,000 元相比，錄得季度降幅 12.4% 至 43,800,000 元，主要是由於收到研發相關活動補貼所致。
- 二零零九年第四季的一般行政費用與二零零九年第三季的 31,900,000 元相比下降至 25,300,000 元，是由於匯兌收益及律師費用減少所致。

- 二零零九年第四季的销售费用由二零零九年第三季的 7,700,000 元上升至 7,800,000 元，录得季度升幅 0.9%。
- 二零零九年第四季经营活动下认列的与诉讼和解相关的费用为 269,600,000 元，与长期资产减值相关的费用为 139,100,000 元。包括在非经营性开支项下认列的部分，与诉讼和解相关的费用总计为 299,700,000 元。

## 其他收入（支出）

以千美元计	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度	季度比较	二零零八年 第四季度	年度比较
其他收入（支出）	(29,072)	(3,943)	637.3%	(4,146)	601.2%
利息收入	886	634	39.7%	1,184	-25.2%
利息支出	(32,974)	(7,941)	315.2%	(7,133)	362.3%
汇兑收益（亏损）	1,876	2,441	-23.1%	(2,543)	-
其他，净额	1,140	923	23.5%	4,346	-73.8%

- 合并来自于经营活动的汇兑损益，公司于二零零九年第四季整体录得汇兑收益 3,100,000 元，二零零九年第三季录得汇兑亏损 500,000 元。
- 二零零九年第四季利息费用增加是由于与诉讼和解相关的股权及认购权证授予协定的公平价值改变所致，金额为 30,100,000 元。

## 折舊及攤銷

- 二零零九年第四季的折舊及攤銷總額為 183,600,000 元，相較於二零零九年第三季的 198,900,000 元。
- 二零零九年的折舊及攤銷總額為 793,200,000 元，相較於二零零八年的 805,600,000 元。

## 流動資金

以千美元計	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度
現金及現金等價物	443,463	453,285
限制性現金	20,360	20,071
短期投資	-	6,110
應收賬款	193,994	194,202
存貨	193,705	186,839
其他	38,530	25,896
流動資產總計	890,052	886,403
應付賬款	228,883	175,170
短期借款	286,864	281,243
長期借款的即期部份	249,014	249,395
其他	309,573	142,596
流動負債總計	1,074,334	848,404
現金比率	0.4x	0.5x
速動比率	0.6x	0.7x
流動比率	0.8x	1.0x

## 資本結構

以千美元計	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度
現金及現金等價物	443,463	453,285
限制性現金	20,360	20,071
短期投資	-	6,110
長期票據即期部分	78,608	29,493
長期票據	83,325	9,582
短期借款	286,864	281,243
長期借款的即期部份	249,014	249,395
長期借款	507,423	573,697
總借款	1,043,301	1,104,335
股東權益	1,931,627	2,411,556
總債務股本比率	54.0%	45.8%

## 現金流量概要

以千美元計	二零零九年 第四季度	二零零九年 第三季度
來自於經營活動的現金淨額	89,767	72,954
來自於投資活動的現金淨額	(38,274)	(64,555)
來自於融資活動的現金淨額	(60,941)	9,380
現金變動淨額	(9,822)	17,672

## 資本開支概要

- 二零零九年第四季資本開支為 92,000,000 元。二零零九年的資本開支總額約為 189,900,000 元, 早期提供的二零零九年資本開支預測數為 190,000,000 元。

## 近期公佈

- 關於董事變更之進一步資料 (二零零九年十二月十六日)
- 董事及授權代表變更 (二零零九年十一月十日)
- 和解協定 根據一般授權發行股份、認股權證及認股權證股份及恢復股份買賣 (二零零九年十一月十日)
- 暫停股份買賣 (二零零九年十一月四日)
- 中芯國際 (SMIC) 和 Cadence 共同推出用於 65 納米的低功耗解決方案 Reference Flow 4.0 (二零零九年十月二十九日)
- 中芯截止二零零九年九月三十日止三個月業績公佈 (二零零九年十月二十八日)
- 中芯國際宣佈 MEMS 晶片成功通過 Microstaq 驗證 (二零零九年十月二十六日)
- 中芯國際 2009 技術研討會在上海召開 (二零零九年十月二十三日)
- 中芯國際採用 Cadence DFM 解決方案用於 65 和 45 納米 IP/庫開發和全晶片生產 (二零零九年十月十九日)
- 中芯國際將 45 納米工藝技術延伸至 40 納米以及 55 納米 (二零零九年十月十四日)
- 董事會會議日期通知 (二零零九年十月十三日)

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

[http://www.smics.com/website/enVersion/Press\\_Center/newsRelease.ftl](http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/newsRelease.ftl)

合併資產負債表  
(美元)

截至以下日期止

	二零零九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零零九年 九月三十日 (未經審核)
<b>資產</b>		
流動資產：		
現金及現金等價物	443,462,514	453,284,870
限定用途的現金	20,360,185	20,070,776
短期投資	-	6,110,231
應收賬款，已扣除撥備分別為 二零零九年十二月三十一日 2,678,615 元及二零零九年九月三十 日 6,509,798 元	193,993,648	194,202,163
存貨	193,705,195	186,839,459
預付款項及其它流動資產	28,881,867	25,895,689
待售資產	9,649,029	-
<b>流動資產合計</b>	<b>890,052,438</b>	<b>886,403,188</b>
預付土地使用權	78,111,788	78,486,074
廠房及設備，淨額	2,249,560,703	2,478,950,867
購入無形資產，淨額	182,694,105	192,778,696
遞延成本，淨額	-	29,432,198
股權投資	9,848,148	9,962,419
其他長期預付款	391,741	551,535
長期應收款	133,883,696	131,205,267
遞延稅資產	102,531,851	93,163,395
<b>資產合計</b>	<b>3,647,074,470</b>	<b>3,900,933,639</b>
<b>負債及股東權益</b>		
流動負債：		
應付帳款	228,882,804	175,169,952
預提費用及其它流動負債	110,668,121	109,116,249
短期借款	286,864,063	281,242,502
長期票據的即期部份	78,608,288	29,492,873
長期借款的即期部份	249,014,080	249,395,373
與訴訟和解相關的股份發行及認購權 證的協定	120,237,773	-
應付所得稅	58,573	3,986,995
<b>流動負債合計</b>	<b>1,074,333,702</b>	<b>848,403,944</b>

長期負債：

長期票據	83,324,641	9,581,864
長期借款	507,423,099	573,696,518
與特許權協定相關的長期應付款	4,779,562	16,674,534
其他長期負債	9,709,690	6,000,000
遞延稅負債	1,035,164	453,205
<b>長期負債合計</b>	<b>606,272,156</b>	<b>606,406,121</b>

**負債合計** **1,680,605,858** **1,454,810,065**

非控制權益 34,841,507 34,567,186

股東權益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，於二零零九年十二月三十一日及二零零九年九月三十日法定及已發行股份分別為 22,375,886,604 股及 22,366,133,058 股。

8,950,355 8,946,454

額外繳入股本 3,499,723,153 3,497,010,545

累計其他綜合虧損 (386,164) (8,293)

累計虧絀 (1,576,660,239) (1,094,392,318)

**所有股東權益合計** **1,931,627,105** **2,411,556,388**

**總負債，非控制權益及股東權益合計** **3,647,074,470** **3,900,933,639**

合併營運報表  
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零零九年 九月三十日 (未經審核)
銷售額	333,089,885	323,355,915
銷售成本	297,809,940	320,702,261
<b>毛利</b>	<b>35,279,945</b>	<b>2,653,654</b>
經營費用：		
研究和開發	43,805,597	50,003,000
一般及行政	25,297,079	31,922,632
銷售和市場推廣	7,759,965	7,693,241
購入無形資產攤銷	7,640,689	9,535,274
長期資產減值損失	139,096,602	—
來自廠房設備和其他固定資產的銷售 損失	3,585,371	29,475
訴訟和解	269,637,431	—
<b>經營費用總額</b>	<b>496,822,734</b>	<b>99,183,622</b>
<b>經營虧損</b>	<b>(461,542,789)</b>	<b>(96,529,968)</b>
其他收入(支出)：		
利息收入	886,374	633,879
利息支出	(2,873,955)	(7,941,202)
利息支出-訴訟和解相關	(30,100,793)	—
匯兌收益	1,876,327	2,441,374
其他,淨額	1,140,265	923,152
<b>其他支出,淨額</b>	<b>(29,071,782)</b>	<b>(3,942,797)</b>
<b>所得稅前虧損</b>	<b>(490,614,571)</b>	<b>(100,472,765)</b>
所得稅利益	8,735,242	31,704,196
股權投資虧損	(114,272)	(312,752)
<b>淨虧損</b>	<b>(481,993,601)</b>	<b>(69,081,321)</b>
非控制權益持有人利息	(274,320)	(264,658)

中芯國際應佔虧損	<b>(482,267,921)</b>	<b>(69,345,979)</b>
每股股份淨虧損，基本及攤薄	(0.0216)	(0.0031)
每股美國預托股份淨虧損，基本及攤薄	(1.0779)	(0.1550)
<b>用作計算基本及攤薄每股普通股 虧損額的股份</b>	<b>22,370,036,361</b>	<b>22,368,419,207</b>
中芯國際普通股股東應佔虧損	<b>(482,267,921)</b>	<b>(69,345,979)</b>

合併現金流量表  
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零九年 十二月三十一日 (未經審核)	二零零九年 九月三十日 (未經審核)
<b>經營活動：</b>		
<b>淨虧損</b>	<b>(481,993,601)</b>	<b>(69,081,321)</b>
<b>淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：</b>		
遞延稅	(8,786,497)	(35,795,067)
處置設備及其它長期資產損失	3,585,371	29,475
折舊及攤銷	173,289,965	186,777,756
購入無形資產攤銷	7,640,689	9,535,274
股權報酬	2,620,497	2,622,067
長期票據及與特許權協定相關的長期應付款的 非現金利息費用	1,068,177	736,747
股權投資虧損	114,272	312,752
長期資產減值損失	139,096,602	-
訴訟和解	239,637,431	-
利息費用-訴訟和解	30,100,793	-
<b>營運資產及負債的變動：</b>		
應收賬款，淨額	208,515	(33,020,992)
長期應收款	(2,678,429)	(133,214)
存貨	(6,865,736)	(3,827,691)
預付款及其它流動資產	(2,826,384)	(6,745,362)
應付賬款	4,697,376	(1,498,671)
預提費用及其它流動負債	(8,923,223)	16,907,154
其他長期負債	3,709,690	3,000,000
應付所得稅	(3,928,422)	3,135,456
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>89,767,086</b>	<b>72,954,363</b>
<b>投資活動：</b>		
購入廠房、設備及土地使用權	(47,502,152)	(51,439,333)

政府授予購買廠房及設備所得款項	11,749,969	19,692,334
出售設備所得款項	1,108,193	779,075
出售待售資產所得款項	737,986	–
購買所獲無形資產	(10,189,252)	(33,298,688)
購買短期投資	(6,802,116)	(6,027,164)
出售短期投資	12,912,347	3,229,525
轉換限定用途的現金	(289,409)	2,508,855
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(38,274,434)</b>	<b>(64,555,396)</b>
<b>融資活動：</b>		
短期借款所得款項	175,741,829	153,106,179
償還短期借款支付的款項	(170,120,268)	(145,541,751)
長期借款所得款項	49,195,984	51,749,585
償還長期借款支付的款項	(115,850,696)	(50,000,000)
行使雇員購股權所得款項	92,079	65,832
<b>融資活動所得(所耗)現金淨額</b>	<b>(60,941,072)</b>	<b>9,379,845</b>
匯率變動的影響	(373,936)	(107,239)
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>	<b>(9,822,356)</b>	<b>17,671,573</b>
<b>現金及現金等價物—期間開始</b>	453,284,870	435,613,297
<b>現金及現金等價物—期間結束</b>	<b>443,462,514</b>	<b>453,284,870</b>

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周杰先生（及周杰先生的替任董事汪正綱先生），以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
王寧國  
總裁，首席執行官  
執行董事

中國上海

二零二零年二月九日

\* 僅供識別